

AVT-Labor

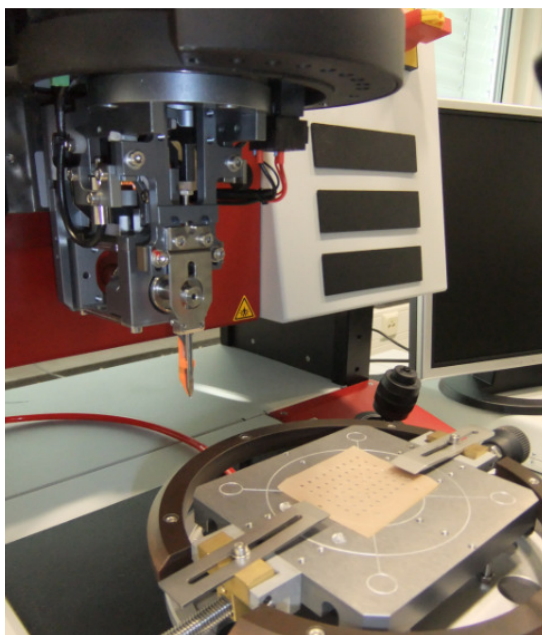
Beschreibung:

Das Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT) Labor bietet mit hochwertiger Ausstattung die Möglichkeit Bondverbindungen an Leistungshalbleitern aufzubauen und zu testen.

Weiterhin werden aktuelle Projektarbeiten aus den Bereichen Sintertechnik und Thermographie von Motorendstufen aufgebaut.

Ausstattung:

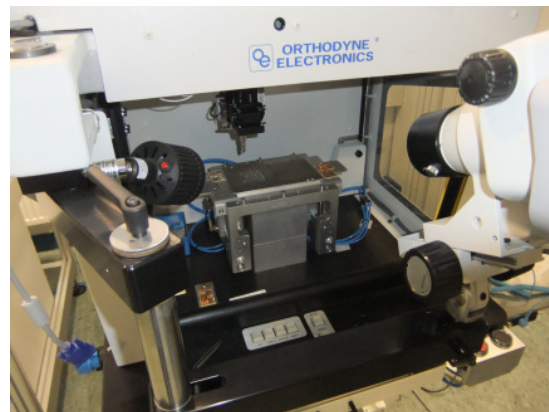
- Orthodyne Electronics Bondmaschine
- Delvotec Keyboard Wirebonder
- XYZTEC Bondtester
- KEYENCE Digital-Mikroskop



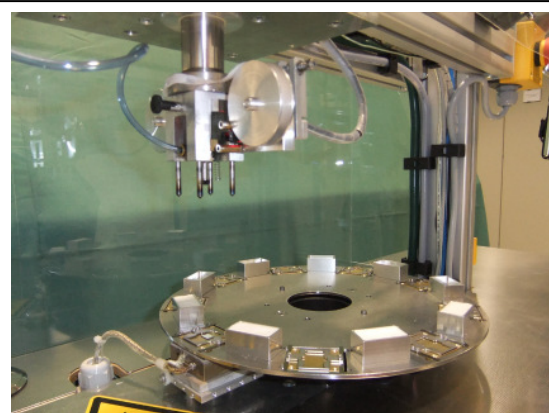
Keyboard Wirebonder

Laborinformation:

Raum	C12-3.28
Laborleitung:	Prof. Dr. Roland Eisele
Inhalt:	Aufbau und Verbindungstechnik, Projektarbeiten Abschlussarbeiten



Bondmaschine im AVT-Labor



Projektarbeit halbautomatisches Sintern